

圣邦微电子（北京）股份有限公司

关于刊发境外上市股份（H股）发行聆讯后资料集的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。

2025年9月28日，公司向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。根据本次发行及上市的时间安排及香港联交所的相关规定，公司于2026年4月1日向香港联交所更新递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请资料。具体内容详见公司分别于2025年9月29日、2026年4月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-097）、《关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申请的进展公告》（公告编号：2026-018）。

2026年3月26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于圣邦微电子（北京）股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕673号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于2026年4月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-017）。

2026年5月14日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行并上市的申请。具体内容详见公司于2026年5月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于香港联交所审议公司发行H股的公告》（公告编号：2026-031）。

根据本次发行并上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登

本次发行并上市聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合格的投资者，除此之外并无任何其他目的。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。

鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接供查阅：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108394/documents/sehk26060400037_c.pdf

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108394/documents/sehk26060400038.pdf>

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。

公司本次发行并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构的批准和/或核准，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，尚存在不确定性。公司将根据相关法律法规以及本次发行并上市的相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2026年6月4日